



# 株主通信

2022年12月期第2四半期業績のご報告  
(2022年1月1日～2022年6月30日)

株主の皆さまにおかれましては、  
平素より格別のご厚情を賜り、  
厚く御礼申し上げます。

代表取締役社長 長谷川 正義



第52期（2022年12月期）第2四半期連結累計期間におけるエレクトロニクス市場は、原材料や半導体デバイスの供給不足の影響、新型コロナウイルス感染症による中国一部地域でのロックダウン、ロシアによるウクライナ侵攻の緊迫化などにより、年初より先行き不透明な状況となりました。また、米国金利の上昇、急速に進むドル高など、世界規模での物価高により消費へも影響が出始めております。

半導体市場では、メモリ半導体において取引価格の下落基調が強まっているものの、5G通信の本格的な普及や産業機器のIoT化を背景に、活発なデータセンター投資が継続し、その基盤となるメモリ半導体の需要は高水準で継続いたしました。

一方、FPD市場においては、テレビやパソコン用モニタなど液晶パネルの需要が減速し、価格の下落などにより投資計画が遅延しています。

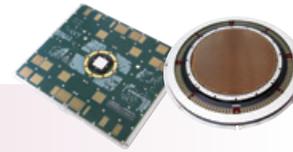
このような事業環境において、当社グループの当第2四半期の連結累計売上高は、メモリ向けプローブカード及びノンメモリ向けプローブカードが好調に推移しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高19,570百万円（前年同期比11.5%増）、営業利益4,101百万円（前年同期比6.8%増）、経常利益4,445百万円（前年同期比9.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,873百万円（前年同期比2.9%増）となりました。

第52期下期においては、不安定な世界経済、半導体市場の不透明感はあるものの、上期の受注が好調だったこともあり、過去最高の売上を見込んでおります。引き続き、生産体制の強靱化にも取り組み、さらなる成長を実現していく決意です。

株主の皆さまにおかれましては、引き続き、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## プローブカード事業



第2四半期累計

売上高

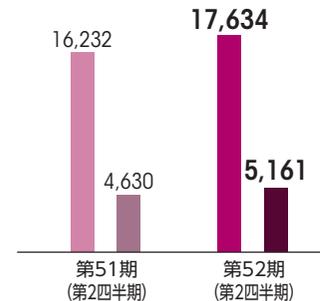
17,634 百万円 前年同期比 8.6%増

セグメント利益

5,161 百万円 前年同期比 11.5%増

売上高/セグメント利益(百万円)

■売上高 ■セグメント利益



堅調な需要が継続したことで、売上高は、ほぼ計画通りとなり、メモリ向け、ノンメモリ向けプローブカードともに前年同期比で増収となりました。利益面においても、安定稼働が継続したことで高い利益水準となりました。

この結果、売上高は17,634百万円(前年同期比8.6%増)、セグメント利益は5,161百万円(前年同期比11.5%増)となりました。

特に第2四半期の受注高は四半期で過去最高の約114億となり、半導体市場の減速感が伝えられるなか、下期に向けて好調な受注となりました。

第52期よりテストソケットビジネスを、プローブカード事業からTE事業へ移管しているため、第51期の数値は組替えて記載しております。

## TE事業



第2四半期累計

売上高

1,935 百万円 前年同期比 46.4%増

セグメント利益

119 百万円 前年同期比 33.2%減

売上高/セグメント利益(百万円)

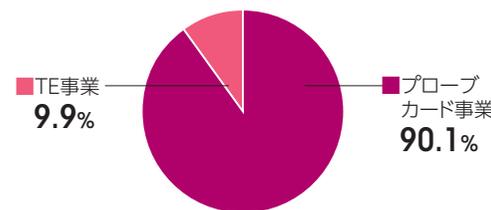
■売上高 ■セグメント利益



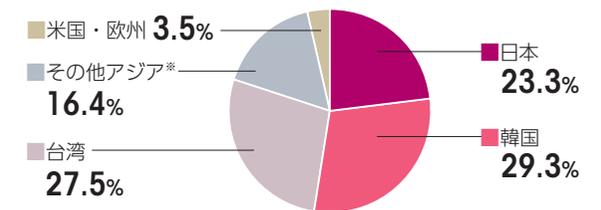
売上高は、プローブユニット及び半導体テストソケットが堅調なビジネスを継続し、前年同期比で増収となりました。この結果、売上高は1,935百万円(前年同期比46.4%増)、セグメント利益は119百万円(前年同期比33.2%減)となりました。

利益は前年同期比で減益となりましたが、前期は特殊要因(引当金の戻し益:約2.5億円)があったため、事業成績での比較では増益となります。

セグメント別売上高構成比(%)



地域別売上高構成比(%)



\*その他アジア：日本、韓国、台湾を除くアジア地域



## 生産体制の最適化と主力製品の さらなるシェア拡大に取り組んでまいります

当社独自の総合管理システムであるQDCCSSにおいて、業務の効率化やコスト削減に取り組んだ成果だと考えております。

TE事業では今期プローブカード事業から移管したパッケージプローブが、堅調な売上となりました。また、プローブユニットにおいてはFPD市場の減速にもかかわらず、計画通りの売上となりました。

このような環境において、生産能力の拡充や基幹製品の拡販に取り組んだ結果、上期の連結業績は前年同期比で増収増益となり、また下期に向けた受注も第2四半期に過去最高の受注を頂ける結果となりました。

**Q** 第52期(2022年12月期)上期の事業環境と連結業績を総括してください。

**A** 上期の事業環境は、半導体市場においてスマートフォン向け、パソコン向けがやや減速したものの、データセンター投資が堅調を維持したことから、当社のメモリ向けプローブカードに対する需要も好調となりました。しかし、期初に計画した上期売上は、その一部が下期にシフトする見通しとなりました。そのため、売上は若干未達となりましたが、利益においては計画を上回ることができました。これは、

**Q** 拡大するプローブカードのニーズに対応するための設備投資について教えてください。

**A** 上期において2件の設備投資を決定いたしました。国内では、アドバンスタイプタイプのプローブカードを手掛ける青森工場の新棟建設です。竣工は2024年8月を予定しており、これにより青森工場の建築面積は現在の

2.3倍に拡大いたします。より効率的な生産プロセスを構築し、メモリ向けプローブカードの需要拡大及びノンメモリ向けプローブカードの販売拡大に対応いたします。

海外では、韓国の100%子会社MEK Co.,Ltd.において、アドバンスプローブカードを生産する新工場を建設し、旺盛な需要に対応していく計画です。新工場の竣工は2023年6月を予定しており、これらの大型投資を計画的に進めてまいります。

当社グループは、今後も主に半導体の市場動向、需要動向を注視しつつ、プローブカードの生産体制の最適化を図ってまいります。

**Q** 第52期(2022年12月期)下期の事業環境と今後の見通しをお聞かせください。

**A** 下期の事業環境は、引き続きデータセンター向けサーバー需要が継続し、堅調に推移するものと予測しております。特にDRAM向けプローブカードは、過去にない高い売上を見込んでおり、しっかりとした計画のもと生

産対応を進めていきます。同時に景気後退に伴う在庫調整や設備投資削減などに注視して参ります。

今後の事業環境は、短期的な需要動向に懸念はあるものの、5G通信の浸透を背景とした企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の進展、産業機器のIoT化に伴うデータトラフィックの増加、自動車の電動化等を背景とした車載半導体の市場拡大などにより、半導体市場は堅調に拡大すると見込んでおります。当社グループはこうした良好な市場環境を事業に結び付け、企業成長に繋げていきたいと考えています。



**製品分野別の課題と成長戦略についてお聞かせください。**



当社の主力製品であるメモリ向けプローブカードにおいては、シェアNo.1のポジションを維持し、さらに積極的なシェアの拡大に注力します。そのため、引き続き積極的に研究開発投資をおこなっていきます。ま

た、顧客の需要へタイムリーに応えるため、効率的な生産工程の整備により、製品リードタイムの短縮、生産能力の拡張を進める計画です。

ノンメモリ向けプローブカードにおいては、車載市場向けのさらなる販売拡大に注力するとともに、MEMSタイプのプローブの開発を進め、市場シェアの拡大をめざします。

TE事業においては引き続き半導体検査関連の新製品開発を進めております。また、今期プローブカード事業部より移管したテストソケットの拡販に取り組んでいく方針です。



**サステナビリティへの取り組みについてお聞かせください。**



取り組むべきことは多々ありますが、ここでは2点お伝えしたいと思います。まず、生産活動における環境負荷の低減に努めることです。自動車やエレクトロニクス製品の進化に寄与する製品を安定的に供給する一

方、重大な社会的責務を担うプライム企業として、環境問題への一層の取り組みが必須だと考えています。次に人材開発の強化です。当社グループの次代を牽引する人材の育成と活用に取り組むとともに、働きやすい職場環境の形成やダイバーシティの推進に力を注いでいきます。

これらを含む取り組みや成果は、今後順次開示していきたいと考えております。



**最後に株主の皆さまにメッセージをお願いします。**



当社は株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題と位置づけており、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。現在の経営成績に甘んじることなく、中長期的な視点で実効性ある投資を行い、その果実を株主の皆さまと分かち合いたいと考えています。株主の皆さまにはなお一層のご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

## Earnings Forecast

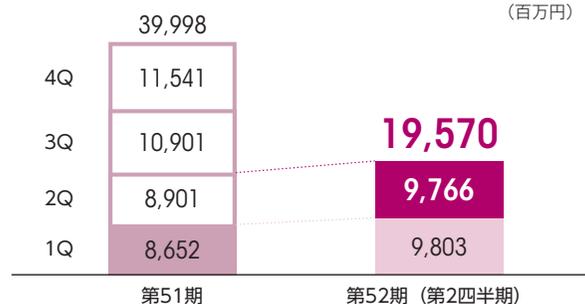
業績予想（2022年8月9日現在）

	第52期 第2四半期累計実績	第52期 第3四半期累計予想	第52期累計（通期）予想
売上高	19,570 百万円	32,300 百万円	47,000 百万円
営業利益	4,101 百万円	7,200 百万円	10,400 百万円
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	2,873 百万円	4,800 百万円	7,000 百万円
配当	—	—	55 円

売上高

19,570 百万円 前年同期比 11.5%増

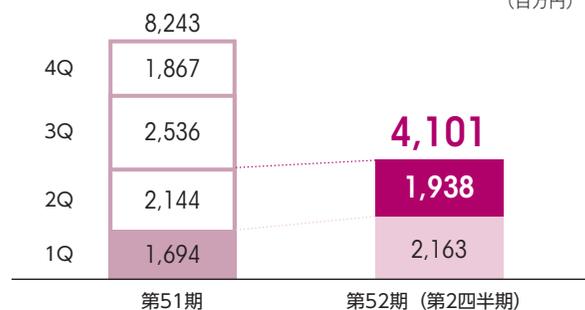
(百万円)



営業利益

4,101 百万円 前年同期比 6.8%増

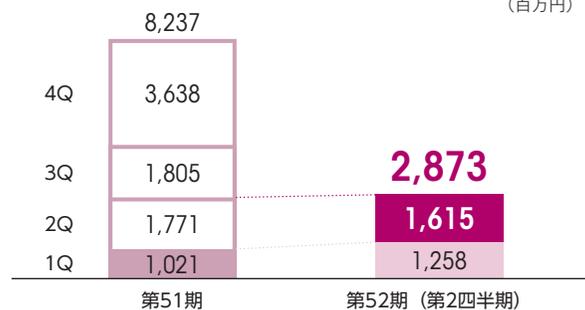
(百万円)



親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

2,873 百万円 前年同期比 2.9%増

(百万円)



※各四半期の実績は、百万円以下切り捨てて表記しております。

## TOPICS &gt;&gt; 新工場建設



当社では、主力工場である青森工場の新棟建設と韓国現地法人のMEK Co.,Ltd.における新工場建設を決定いたしました。近年の半導体需要の高まりを受け、プローブカードの需要増加に対し、既存工場の生産能力増強で対応してきました。しかし、高い稼働率が継続しており、今後も中長期的には更なる成長が予想される半導体市場の要求に応えるため、この投資を決定いたしました。

新工場の建設により、生産能力を増強することで、これまで以上に顧客要求にフレキシブルに対応できます。メモリー向けプローブカードの需要拡大への対応と、ノンメモリープローブカードの販売拡大に注力し、当社シェアの拡大をめざします。

## About Stocks

## 株式事務についてのご案内

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

連絡 先 東京都府中市日鋼町1-1

電話0120-232-711 (通話料無料)

郵送 先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部株式会社 **日本マイクロニクス**

〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8

<https://www.mjc.co.jp/>